

岡本工作機械

セミコンジャパン2017出展のご案内

部品・材料ゾーン

Booth No. **2421** (HALL2)



ハイブリッドマテリアルの総合砥粒加工提案

「技術の岡本」をスローガンに、総合砥粒加工機メーカーとして6つの提案を致します。

1

ハイブリッドマテリアルに対して

WLCSP研削におけるCu+モールド樹脂加工また、
TSV研削におけるCu+Si等の異種混合材同時平坦
化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

2

次世代パワーデバイス用材料

SiC・GaN等への低ダメージ、高速加工技術と装置

3

バンプウエーハの薄化

BGテープの高精度研削技術

4

TSV

TTV自動補正を含めた新プロセス

5

450mmウエーハ

次世代450mmウエーハ加工対応装置

6

電子部品

LT/LN等の電子部品の研削装置

Okamoto

<http://www.okamoto.co.jp>